

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

## 北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	Obeikan Investment Group（沙特奥贝坎投资集团） Imtiaz Mahtab（风投主管）
时间	2025年1月24日 11:00-14:30
地点	赛微电子北京 MEMS 产业基地会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：张阿斌 投资者关系助理：甘世延
投资者关系活动主要内容介绍	<b>第一部分：公司介绍</b> 上市公司介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、产业角色、全球化布局、发展战略、商业模式、竞争格局等。赛微电子专注 MEMS 芯片制造主业，持续提升境内外产线的产能利用率及良率。公司看好万物互联与人工智能背景下智能传感芯片行业的未来发展空间，同时对自身的 MEMS 芯片制造工艺及综合竞争实力充满信心。 <b>第二部分：上市公司解答提问，主要如下：</b> <b>1、公司如何看待 MEMS 行业的纯代工模式及 IDM 模式？</b> 答：Imtiaz Mahtab 先生拥有 IC 芯片制造行业的经验，对 MEMS

也比较熟悉；在公司看来，每家公司的业务发展模式都是根据自身的资源及业务特点确定的，公司非常尊重各类厂商（包括客户）自身的战略考虑。但同时非常明显，半导体制造产线的建设具有长周期、重资产投入的特点，且某单一领域设计公司投资建设的自有产线一方面较难为同类竞争设计公司服务，另一方面产线向其他产品品类拓展的难度也较大。而公司是专业的纯代工企业，基于长期的工艺开发及生产实践，在同类产品的代工业务方面能够积累较好的工艺技术，在制造环节具有产品迭代和成本控制方面的服务优势，Fabless（无晶圆厂）模式或 Fablite（轻晶圆厂）设计公司与我们合作，可以避免巨大的固定资产投入，可以将资源更多地专注在产品设计及迭代方面，并参与市场竞争。

综合而言，IDM 模式与 Fabless 或 Fablite 模式（对应与纯 Foundry 厂商合作）相比各有优劣，将会是业界长期共存的商业发展模式。

## **2、请问公司如何看待 MEMS 的市场规模？**

答：随着万物互联与智能传感时代的到来，物理世界与数字世界需要相互连接的桥梁，无论科技及应用如何发展，均离不开对真实世界的感知，人、设备、自然世界之间及内部各自之间的感知、联系均需要通过声、热、光、电、磁、运动等等各种基础器件来辅助实现，基础感知及执行器件的应用场景将越来越丰富，通过半导体工艺批量标准化制造的 MEMS 芯片，具备小型化、低成本、低功耗、高集成度等突出特点，正在对部分传统传感器件进行渗透及替代。相比 IC 芯片产业的规模体量，MEMS 芯片产业仍处于发展初期，未来发展前景广阔。

## **3、请问公司 MEMS 业务的客户分布情况如何？**

答：根据 Yole Development 的统计数据，2019-2023 年，公

司连续五年在全球 MEMS 纯代工厂商中位居第一，在 2023 年全球 MEMS 厂商综合排名中居第 27 位。

公司拥有覆盖 MEMS 领域的全面工艺技术储备，关键技术已经成熟并经过多年的生产检验，TSV、TGV、SilVia、MetVia、DRIE 及晶圆键合等技术模块行业领先。

公司 MEMS 客户遍布全球，从北美科技之都到英伦学术重镇，从欧洲制造强国到亚洲新兴经济，从尖端生命科学到日常娱乐消费，从成熟行业巨头到创新创意团队，产品覆盖了通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等诸多领域。公司欢迎与全球各领域大小客户、科研机构及高等院校开展技术与业务合作。

**4、请问公司与其他 MEMS 厂商相比，业务上是否存在差异性，竞争优势和劣势有哪些？**

答：在当前竞争格局下，公司在 MEMS 芯片工艺开发及晶圆制造方面已经深耕超过二十年，存在着显著的竞争优势，主要如下：（1）突出的全球市场竞争地位；（2）先进的制造及工艺技术，掌握了多项在业内极具竞争力的工艺技术和工艺模块；（3）标准化、结构化的工艺模块；（4）覆盖广泛、积累丰富的开发及代工经验；（5）产业长期沉淀、优秀且稳定的人才团队；（6）丰富的知识产权；（7）中立的纯晶圆厂模式；（8）前瞻布局、陆续实现的规模产能与供应能力。

公司截至目前也尚存在一些劣势，即整体产能及营收规模较小，规模效应尚待释放，工艺优势尚未得到完全发挥和体现，境内产线团队的量产实践仍在持续进行。相比其他排名在后的代工厂商以及中国境内的新兴厂商，公司的瑞典产线 Fab1&2 一直保持领先，北京产线 Fab3 到目前为止也已初步展现规模量产能力，在 MEMS 工艺技术的广度及深度方面，以及产品及客户积累等方面，公司旗下产线也均体现出巨大的、

待释放的发展潜力。

**5、请问公司 MEMS 业务的整体收入结构及变化趋势如何？**

答：公司 MEMS 业务的收入结构主要包括通讯、生物医疗、工业汽车和消费电子四大领域，收入结构受客户及终端市场需求的变动所影响。

近年来，公司 MEMS 业务持续增长，客户及晶圆品类持续增加，境内外产线均呈现出积极向上的发展态势。公司于近期公布的 2024 年度业绩预告数据也反映了这一点。

公司的角色是 MEMS 晶圆制造厂商，为下游各领域客户提供优质的工艺开发及晶圆制造服务。基于 MEMS 平台工艺制造的各类智能传感系统是万物互联、人工智能时代背景下可以被广泛应用的基础器件，结合业务实践，公司长期看好下游各领域的未来需求。

**6、请问公司未来的国际化运营思路？对于未来的业务发展，赛微电子有哪些重要布局？**

答：基于当前国际局势紧张及日趋复杂化的考量，对于经济全球化与国际产业链分工协作可能面临的挑战，公司同时在境内外布局建设兼具“工艺开发”与“晶圆制造”功能的制造产线，以同时满足境内外客户的不同需求，致力于形成可支持“内循环”、兼顾“双循环”的代工服务体系；公司同时围绕产业链积极进行产业投资布局，最终致力于成为立足本土、国际化发展的知名半导体科技企业集团。

未来我们将围绕 MEMS 核心业务持续完善产业生态，为全球各领域的 MEMS 设计公司客户服务。在境内，集团依托北京 FAB3，一方面继续扩充产能、继续建设运营面向当前及未来需求的规模量产线；另一方面筹建 MEMS 中试产线，通过提供工艺开发及小批量代工服务，为规模量产线储备并导入相应的

	<p>客户及产品，提高工艺开发及规模量产能力。</p> <p>在境外，集团继续支持瑞典产线添购部分设备、建设此前已收购的半导体产业园区，逐步扩充产能以满足相关客户的需求。</p> <p>与此同时，公司会继续通过直接投资或产业基金投资，积极发掘孵化各类新兴 MEMS 芯片设计公司。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 1 月 24 日